



DÉveloppement de Nouvelles TEchnologies pour Intégration Circuit

Nom du responsable : SAULEAU Ronan

Ronan.Sauleau@univ-rennes1.fr

Equipe de recherche : BEAMS (Dpt ADH)

Thématique du Projet : Prototypage

Type de Projet : Autres projets publics (CEA, CNES, DGA, ESA, ONERA...)

Date de début : 2010

Date de fin : 2014

Resumé : L'objectif de ce projet FUI (2010) a pour ambition de développer et qualifier des technologies

circuit « multicouches » (polymère, hybrides) permettant notamment d'intégrer dans les couches internes du circuit les composants passifs d'un système d'émission-réception hyperfréquence, et le développement et la qualification de la technologie de plasturgie 3D adaptée au circuit imprimé, afin de réaliser des éléments rayonnants innovants (antennes).

Les partenaires sont les suivants : GTID Protecno (coordinateur), IETR (sites de Rennes et de Nantes), Lab-STICC (UBO et Telecom Bretagne), Satimo, Elliptika, Thales (Brest).

Site web du projet :

<http://www.media-and-networks.eu/fr/les-projets/fiche-projets-finances.php?id=260>